

2025年3月期（2024年4月～2025年3月） 東京エレクトロン 決算説明会

2025年4月30日

内容：

- 連結決算の概要 川本 弘 （常務執行役員 ファイナンス本部 ディビジョンオフィサー）
- 事業環境および業績予想 河合 利樹 （代表取締役社長・CEO）



将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の事業計画、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、政治経済情勢、半導体市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権、感染症の影響など、さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は軽微です。

2025年3月期 連結決算の概要

2025年4月30日

常務執行役員 ファイナンス本部 ディビジョンオフィサー
川本 弘



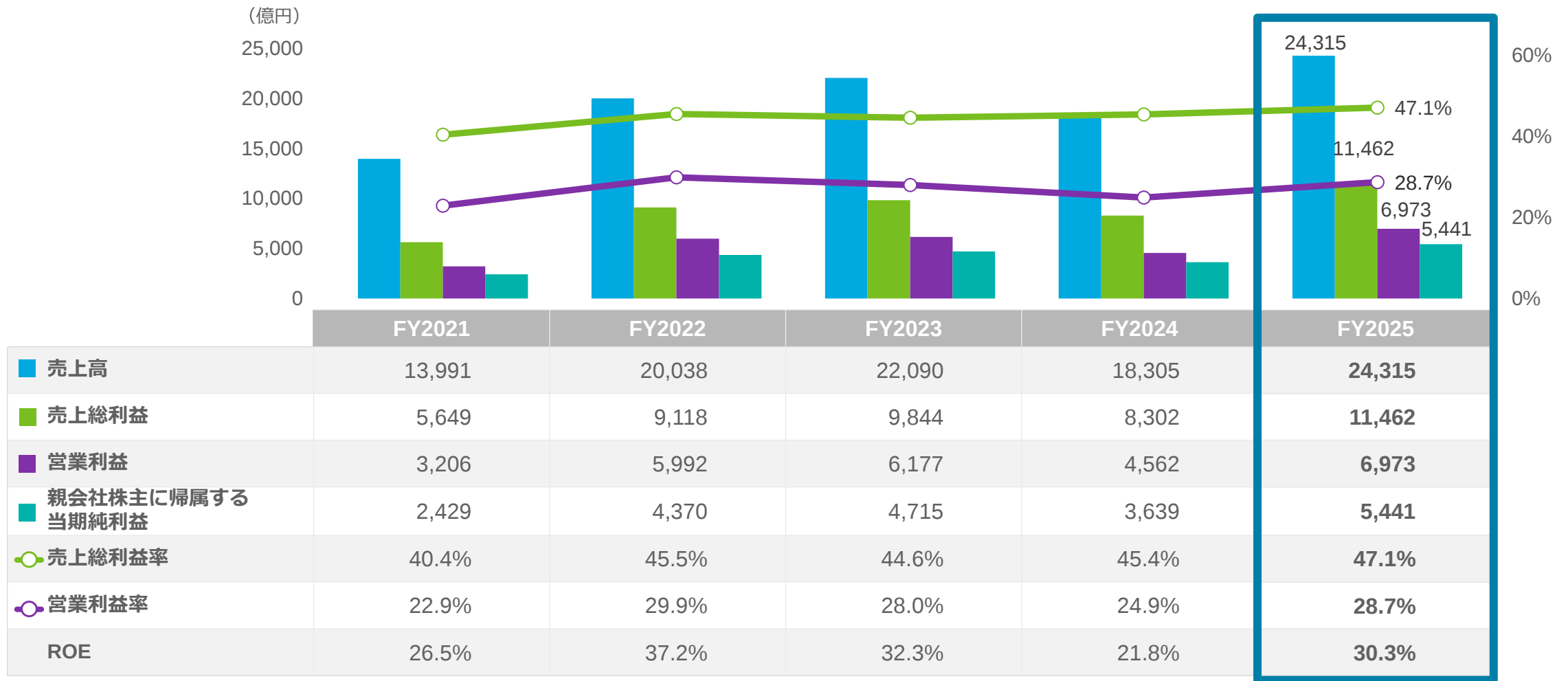
損益状況

(億円)

	FY2024	FY2025	対前期 増減	(ご参考) 2025年2月6日発表の FY2025予想
売上高	18,305	24,315	+32.8%	24,000
売上総利益	8,302	11,462	+38.1%	11,290
売上総利益率	45.4%	47.1%	+1.7pts	47.0%
販管費	3,740	4,489	+20.0%	4,490
営業利益	4,562	6,973	+52.8%	6,800
営業利益率	24.9%	28.7%	+3.8pts	28.3%
税金等調整前当期純利益	4,734	7,061	+49.1%	6,910
親会社株主に帰属する当期純利益	3,639	5,441	+49.5%	5,260
1株当たり当期純利益 (円)	783.75	1,182.40	+50.9%	1,142.47
研究開発費	2,028	2,500	+23.2%	2,540
設備投資額	1,218	1,621	+33.1%	1,700
減価償却費	523	621	+18.7%	630

1. 当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は軽微です。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

損益状況の推移（FY2021～FY2025）



FY2022の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用しています。

売上高・売上総利益・営業利益・当期純利益すべてにおいて、
過去最高の業績を達成

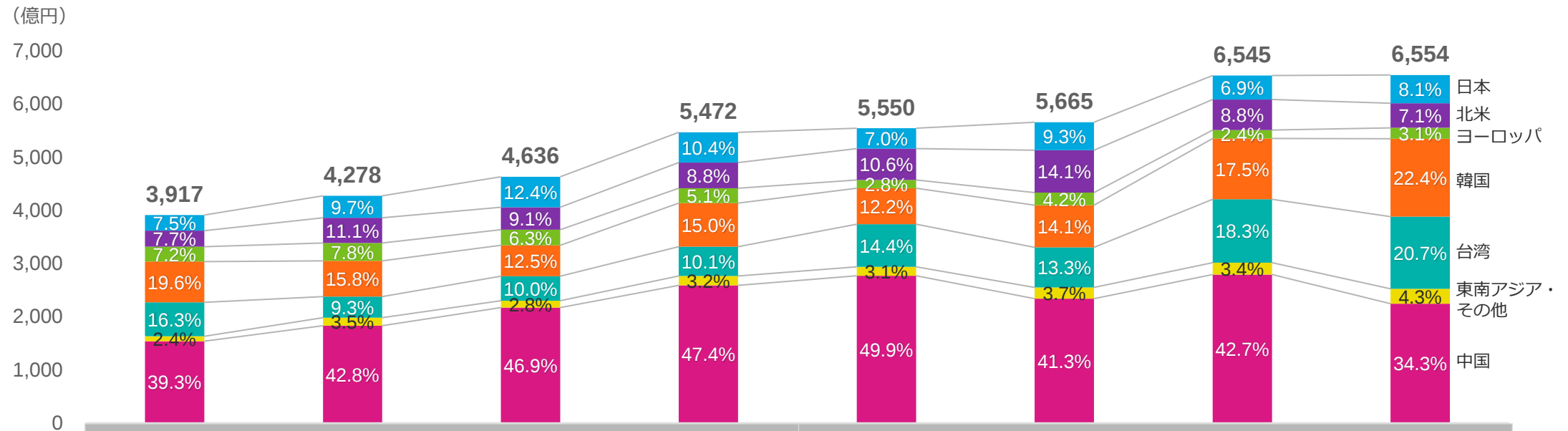
損益状況（四半期）

（億円）

	FY2024	FY2025				vs. FY2025 Q3	vs. FY2024 Q4
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
売上高	5,472	5,550	5,665	6,545	6,554	+0.1%	+19.8%
売上総利益	2,561	2,640	2,599	3,117	3,105	-0.4%	+21.3%
売上総利益率	46.8%	47.6%	45.9%	47.6%	47.4%	-0.2pts	+0.6pts
販管費	1,108	982	1,117	1,121	1,267	+13.1%	+14.3%
営業利益	1,452	1,657	1,481	1,996	1,837	-7.9%	+26.6%
営業利益率	26.5%	29.9%	26.2%	30.5%	28.0%	-2.5pts	+1.5pts
税金等調整前当期純利益	1,578	1,672	1,536	2,001	1,851	-7.5%	+17.3%
親会社株主に帰属する当期純利益	1,249	1,261	1,177	1,572	1,429	-9.1%	+14.4%
研究開発費	584	534	620	618	727	+17.7%	+24.5%
設備投資額	329	239	533	502	346	-31.1%	+4.9%
減価償却費	153	132	145	160	183	+14.4%	+19.7%

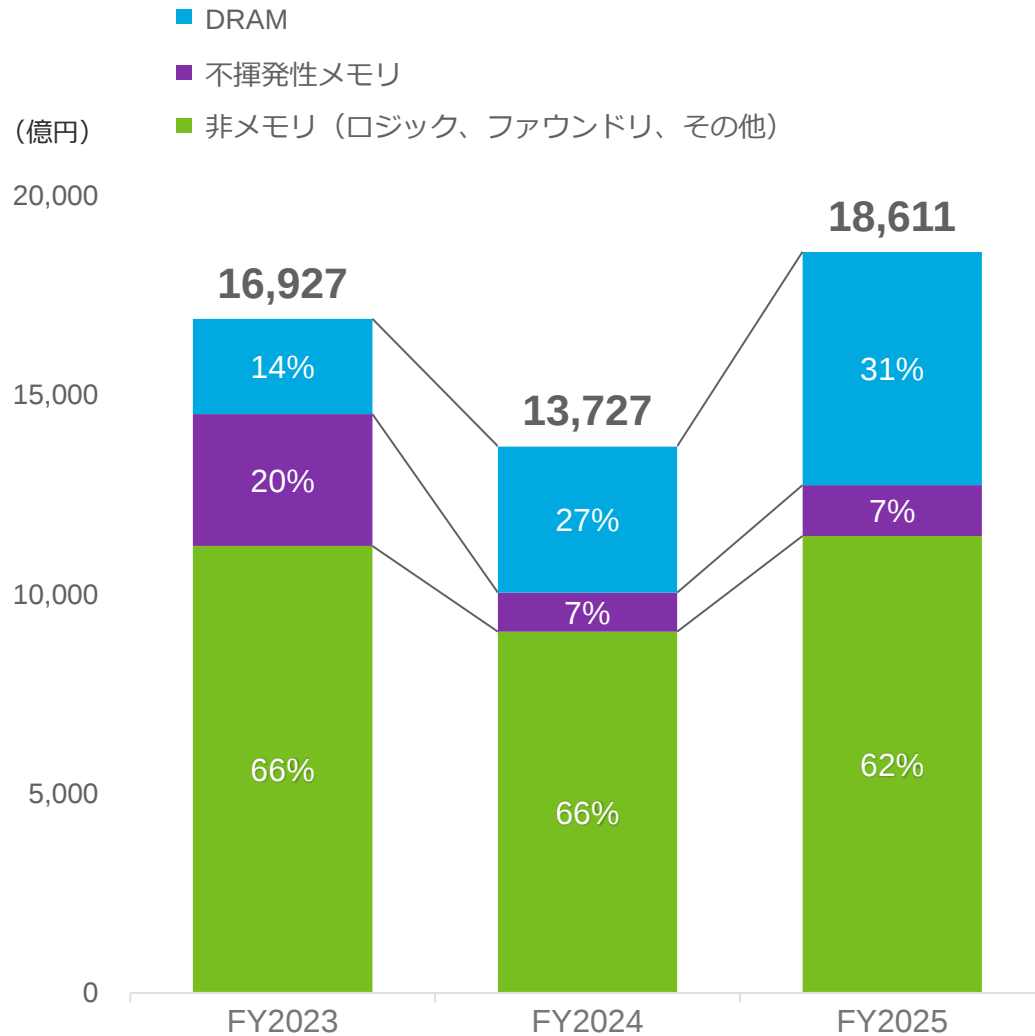
1. 当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は軽微です。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

地域別売上高構成比（FY2024 Q1～FY2025 Q4）



	FY2024				FY2025			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
日本	295	412	574	567	385	526	453	534
北米	301	474	421	483	590	799	577	462
ヨーロッパ	281	335	294	281	155	238	157	203
韓国	767	674	582	820	678	795	1,145	1,470
台湾	639	399	463	552	800	753	1,193	1,358
東南アジア・その他	92	151	127	175	170	212	223	278
中国	1,539	1,829	2,172	2,591	2,770	2,339	2,794	2,246

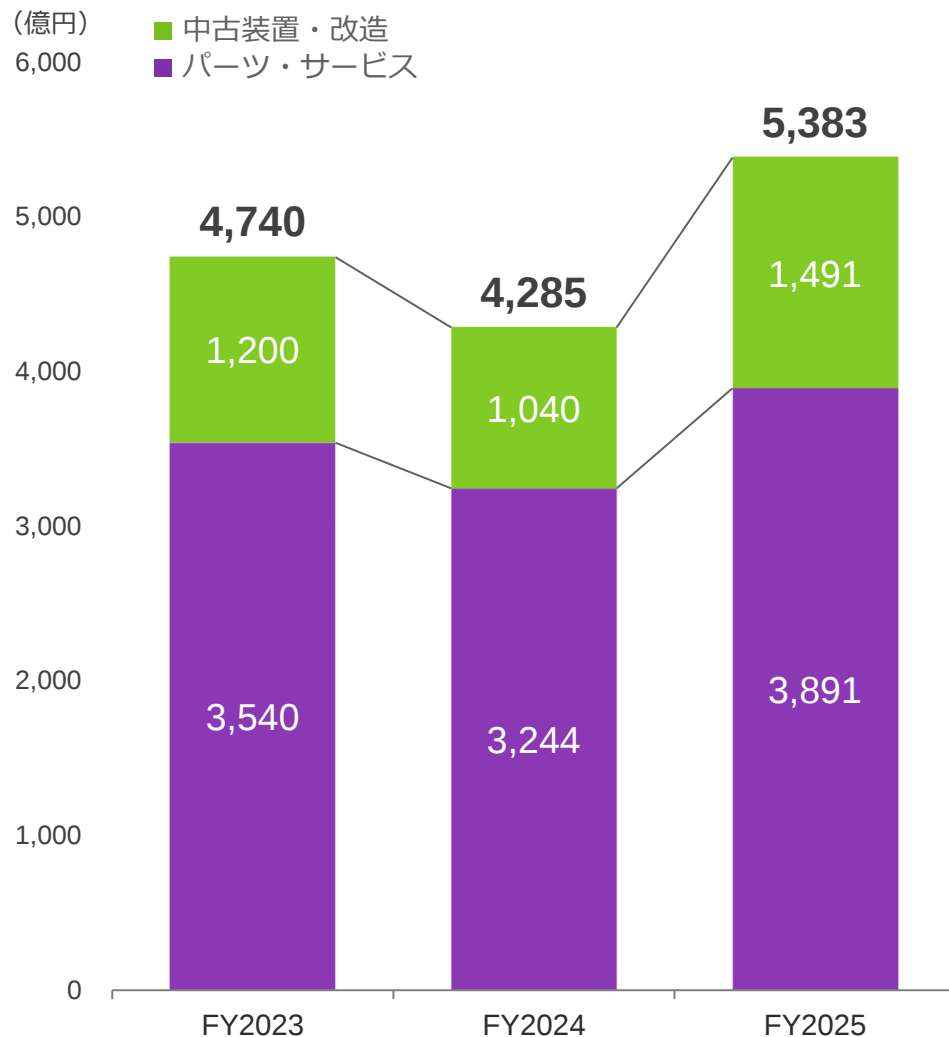
SPE新規装置 アプリケーション別売上構成比



- DRAM：HBM向けなど先端投資が売上・構成比の増加に大きく貢献
- 不揮発性メモリ：構成比は同水準も、顧客の投資は徐々に回復基調に転じ、売上は増加傾向
- 非メモリ：成熟向けの需要に加え、最先端設備投資が活発に行われ、売上は大きく増加

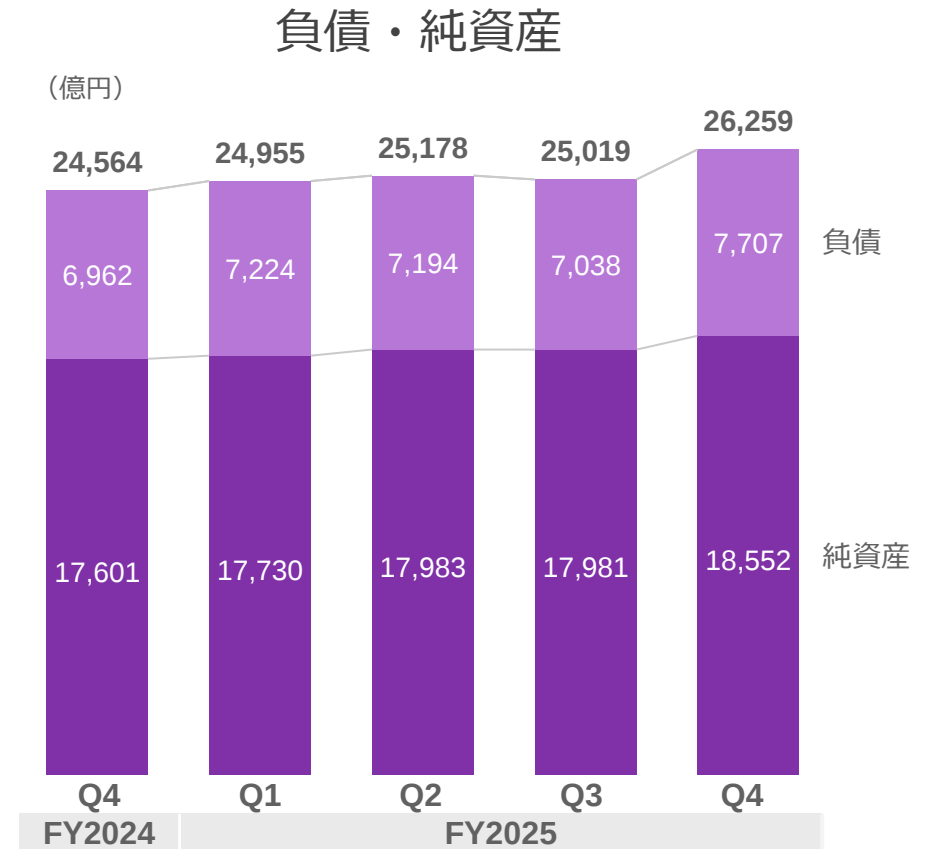
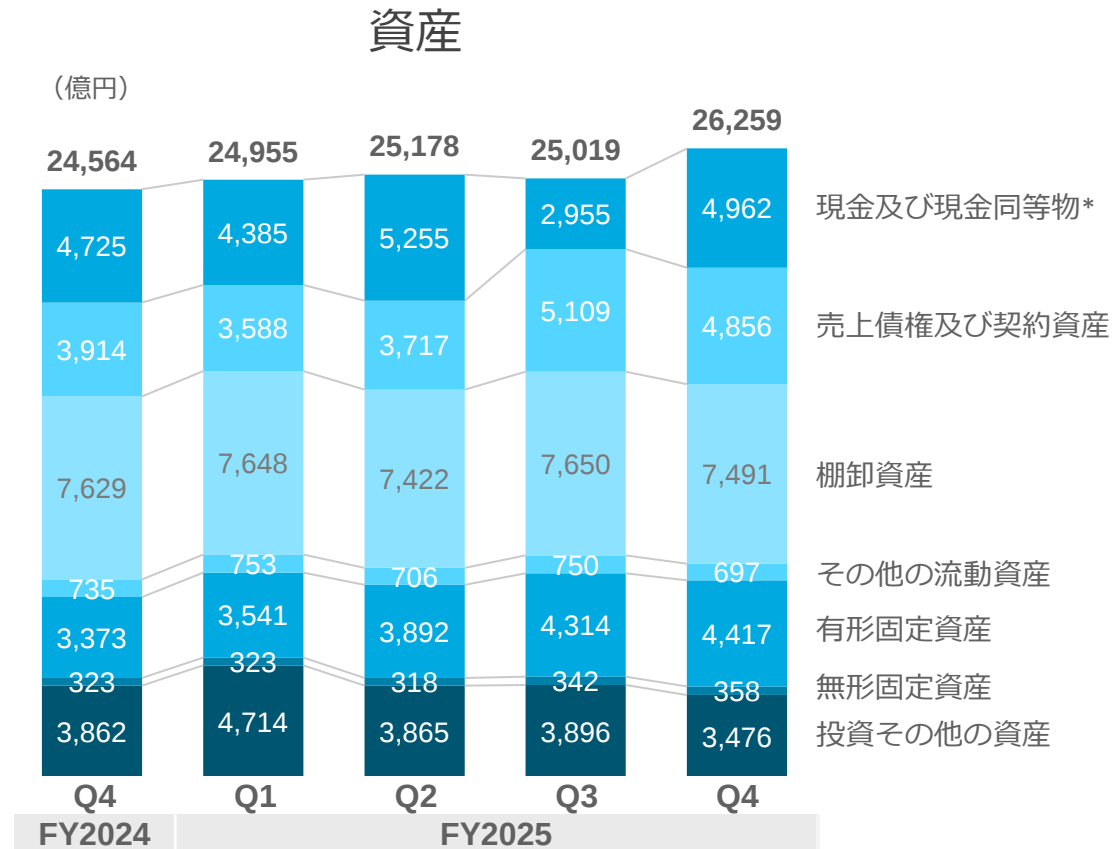
1. SPE（Semiconductor Production Equipment）：半導体製造装置
2. グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューションの売上高は含まれておりません。

フィールドソリューション売上



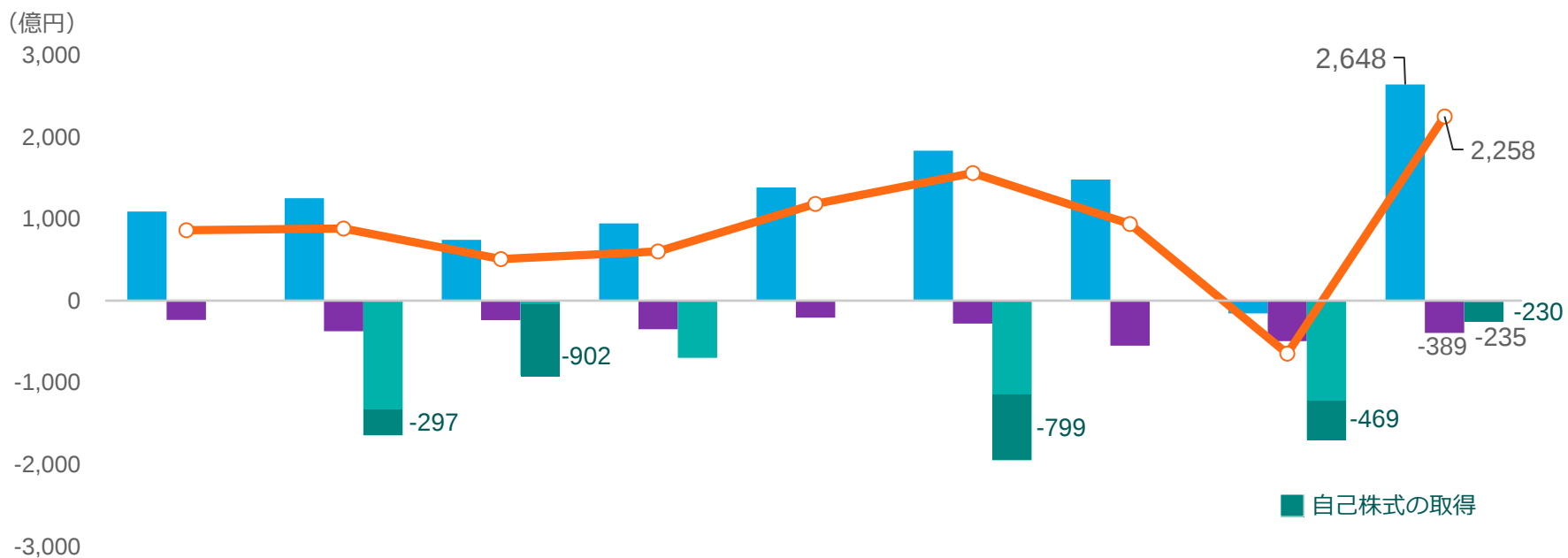
- FY2025の売上は、前期比25.6%増の5,383億円
- 顧客の工場稼働率の回復に伴い、パーツ・サービス、中古装置・改造ともに好調

貸借対照表（四半期）



*現金及び現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

キャッシュ・フロー（四半期）



	FY2023	FY2024				FY2025			
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
■ 営業キャッシュ・フロー	1,096	1,257	748	950	1,390	1,837	1,486	-150	2,648
■ 投資キャッシュ・フロー ^{*1}	-231	-368	-234	-344	-203	-273	-544	-490	-389
■ 財務キャッシュ・フロー	-5	-1,641	-908	-693	-6	-1,944	-6	-1,701	-235
○ フリーキャッシュ・フロー ^{*2}	865	888	514	606	1,187	1,564	941	-641	2,258
手元資金残高 ^{*3}	4,731	4,010	3,626	3,524	4,725	4,385	5,255	2,955	4,962

*1 投資キャッシュ・フローは、定期預金および短期投資の増減を除いた金額です。

*2 フリーキャッシュ・フロー＝営業キャッシュ・フロー＋投資キャッシュ・フロー（定期預金および短期投資の増減を除く）

*3 手元資金は、現金及び現金同等物と満期日または償還日までの期間が3カ月を超える定期預金および短期投資の合計額です。

事業環境および業績予想

2025年4月30日

代表取締役社長・CEO
河合 利樹



FY2025 事業ハイライト

- 売上高、利益とも、過去最高額を達成。売上総利益は初めて1兆円を上回る
 - 売上高成長率は+33%。特にDRAMは、HBM^{*1}向けに幅広い装置群が採用され、+59%と大きく伸長
- マーケットシェア拡大。戦略製品の量産POR^{*2}奪取が寄与
 - エッチング装置：DRAM Capacitor工程で大手顧客独占、NAND Channel工程（極低温 Etch）で新規獲得、Slit工程で拡販、ロジック・HBM向け先端パッケージ配線工程で採用
 - ウェーハボンダー：HBM向けテンポラリーボンダー/デボンダーの需要大幅増
 - プローバ：高シェアを誇る先端ロジック向け投資拡大の潮流を捉え、売上増大
- 新領域への参入により将来の売上貢献が期待される新製品をリリース
 - 枚葉プラズマCVD装置「Episode™ 1」、PVD装置「LEXIA™-EX」、ガスクラスタースタービーム装置「Acrevia™」、レーザー剥離装置「Ulucus™ LX」
- 約1,500億円の自己株式取得を完了

*1 HBM (High Bandwidth Memory) : 高帯域幅DRAM

*2 POR (Process of Record)

事業環境（2025年4月時点でのWFE市場の見方）

■ CY2025：前年同等の\$110B程度と予想

- 車載やパワー半導体投資、中国新興メーカーの投資は一服
- AIサーバー向け需要に伴う最先端ロジックとHBMが投資を牽引

■ CY2026：二桁成長を期待

- 引き続きAIサーバー向け需要は旺盛。2nm量産投資が加速
- PCやスマホへのAI搭載比率の上昇に伴う半導体消費が増加

超高速・大容量・高信頼性・低消費電力の実現に向け、
スケーリングとヘテロジニアスインテグレーションの2軸で技術革新が進展。
GAA^{*1}・BSPDN^{*2}・HBMやテスト工程など、TELの事業機会は拡大

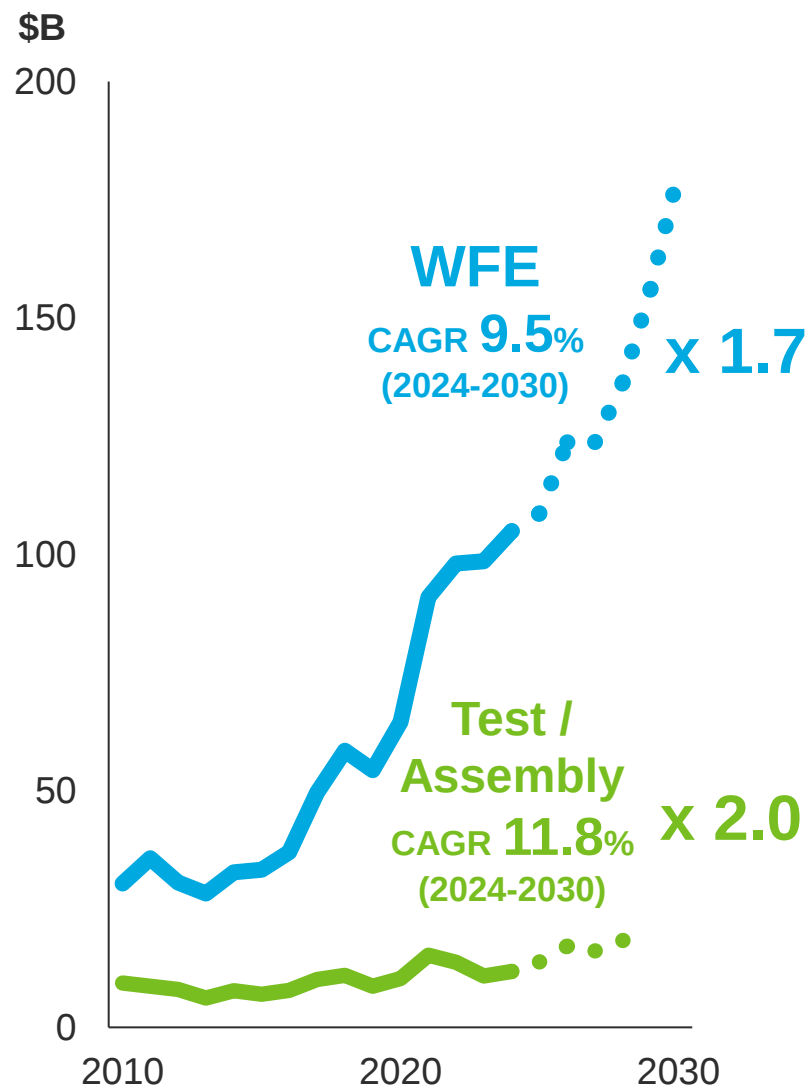
*1 GAA（Gate All Around）

*2 BSPDN（Backside Power Delivery Network）

：トランジスタのチャンネル全面をゲートで覆った構造

：電源供給配線をウェーハの裏面に配置する構造

今後の成長を見据えた注力技術



Source : TechInsights (April 2025)

Investor Relations / April 30, 2025

Frontend		
Logic : GAA, BSPDN - EUV Coater/Developer - Gas Chemical Etch - Conductor Etch - PVD Metal Overburden - CFET/Inner Spacer Plasma CVD for filling film - Double-sided scrubber - Backside/bevel cleaning - Pattern Shaping - Wafer Bonder - Laser Tool	DRAM: 2D & 3D DRAM - EUV Coater/Developer - Capacitor Mold Etch - Batch High-k Capacitor deposition - PVD Metal Hardmask - Supercritical Cleaning - Backside/bevel Cleaning - Wafer Bonder - Laser Tool	NAND: Beyond 4xx - Slit Etch - Channel Hole Etch (Plug) - Batch Mo deposition - Batch Cleaning WL Separation - Wafer Bonder - Laser Tool
Advanced Packaging		
Logic Packaging - Interposer, Polyimide & PR Coater/Developer - TDV Etch - Batch High-k Capacitor depo - Wafer Bonder - Laser Tool	HBM Packaging - Polyimide & PR Coater/Developer - Metal Etch for HBM - Aerosol Cleaning - Temporary Bonder/Debonder	Advanced Logic / Memory Test Prober

FY2026 業績予想

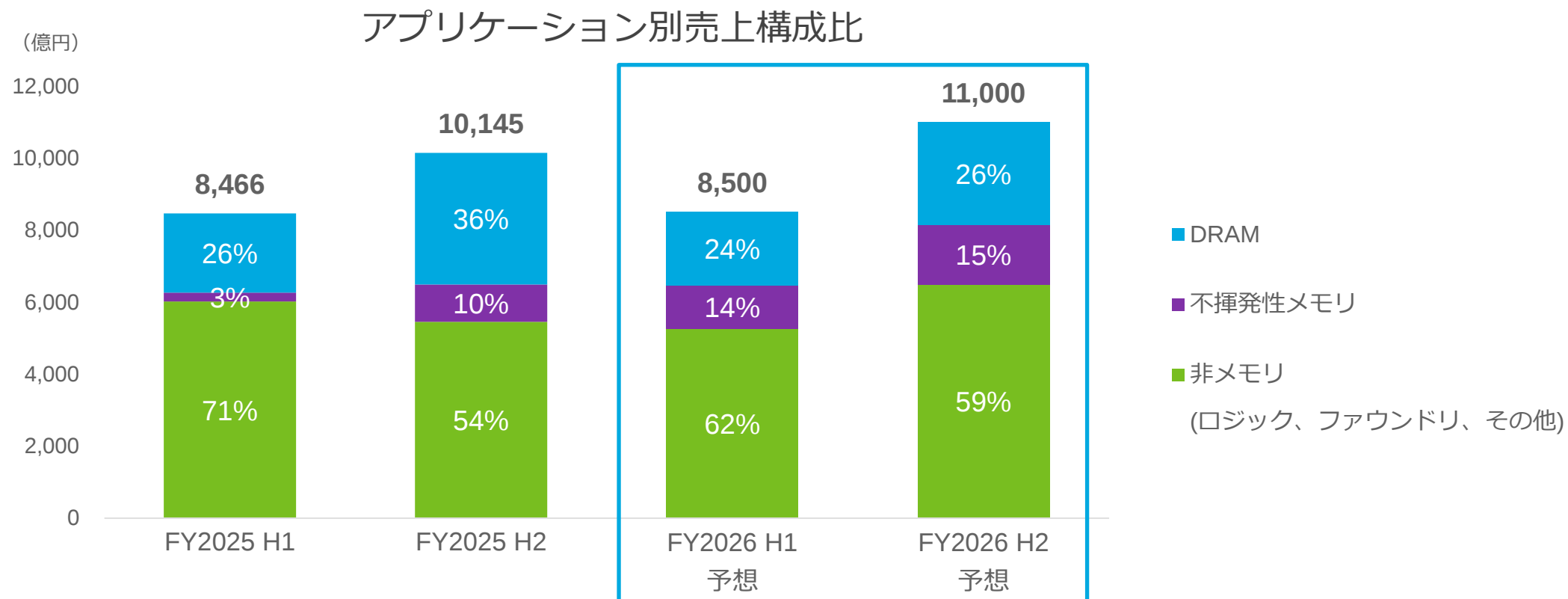
FY2026 業績予想

(億円)

	FY2025 (実績)	FY2026 (予想)			
		H1	H2	通期	通期 YoY
売上高	24,315	11,500	14,500	26,000	+6.9%
売上総利益 売上総利益率	11,462 47.1%	5,270 45.8%	7,010 48.3%	12,280 47.2%	+7.1% +0.1pts
販管費 研究開発費 研究開発費以外の販管費	4,489 2,500 1,989	2,390 1,400 990	2,620 1,600 1,020	5,010 3,000 2,010	+11.6% +20.0% +1.1%
営業利益 営業利益率	6,973 28.7%	2,880 25.0%	4,390 30.3%	7,270 28.0%	+4.3% -0.7pts
税金等調整前当期純利益	7,061	2,930	4,430	7,360	+4.2%
親会社株主に帰属する当期純利益	5,441	2,240	3,420	5,660	+4.0%
1株当たり当期純利益 (円)	1,182.40	488.97	-	1,235.51	+53.11

FY2026も過去最高の売上および営業利益を見込む。
将来の成長機会を最大限取り込むため、3,000億円の研究開発投資を計画

FY2026 SPE新規装置売上予想



グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューション売上高は含まれていません。

CY2026の市場成長に向け、FY2026下期から各社準備を開始すると期待。
FY2026下期は過去最高の半期売上を予想

FY2026 研究開発費・設備投資計画

新開発棟
エッチング装置



宮城県黒川郡
2025年4月 竣工

新開発棟
コート/デベロッパ、洗浄装置、ボンディング装置



熊本県合志市
2025年秋 竣工予定

東北生産・物流センター
成膜装置



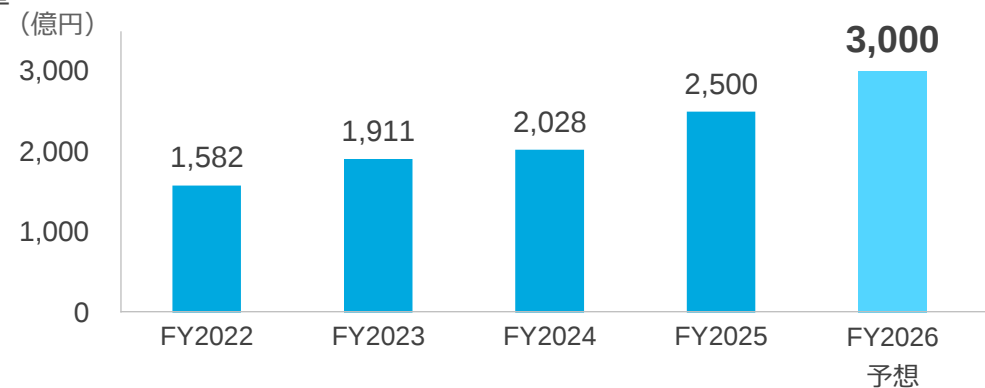
岩手県奥州市
2025年秋 竣工予定

生産新棟
エッチング装置

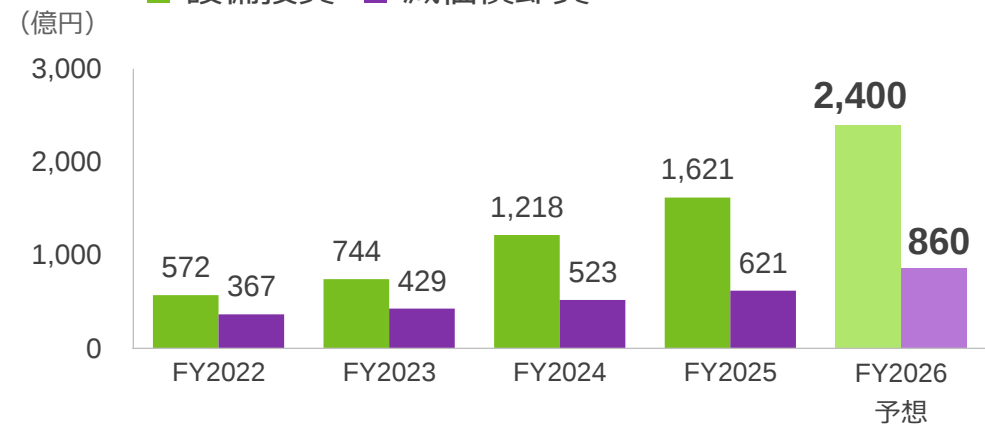


宮城県黒川郡
2027年夏 竣工予定

■ 研究開発費



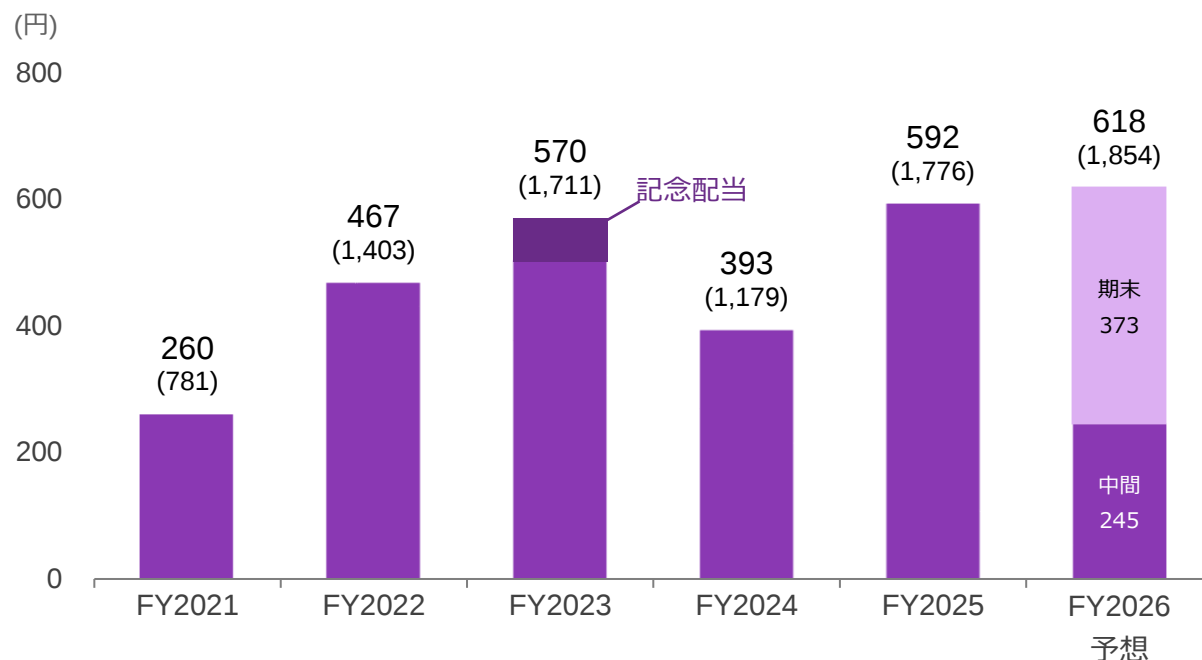
■ 設備投資 ■ 減価償却費



さらなる成長を見据え、積極的な研究開発・設備投資を継続

FY2026 配当予想

1株当たり配当金



- FY2021～2023の1株当たり配当額は、FY2021の期首に株式分割がおこなわれたと仮定した金額を記載しています。
- FY2023には60周年記念配当が含まれます。
- 株式分割がおこなわれる以前の金額を（ ）内で記載しています。

当社の株主還元策

連結配当性向：50%

但し、1株当たり年間配当金50円*を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得：機動的に実施を検討

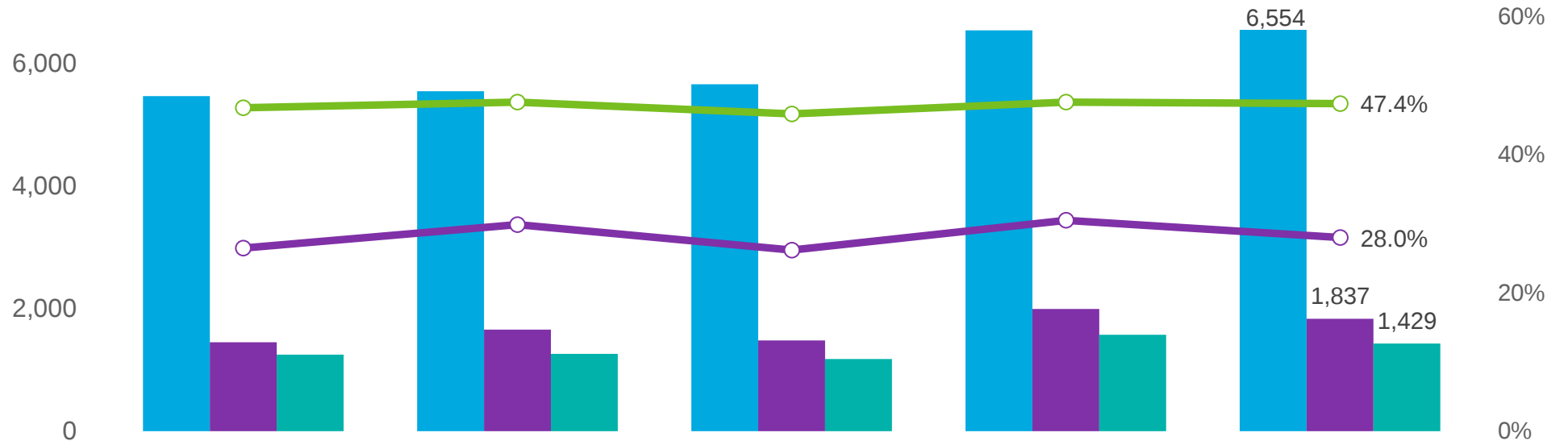
*2023年4月1日付の株式分割により、従来の150円から変更しています。

2023年4月1日付で普通株式1株を3株に分割。通期配当は618円を予定

補足資料

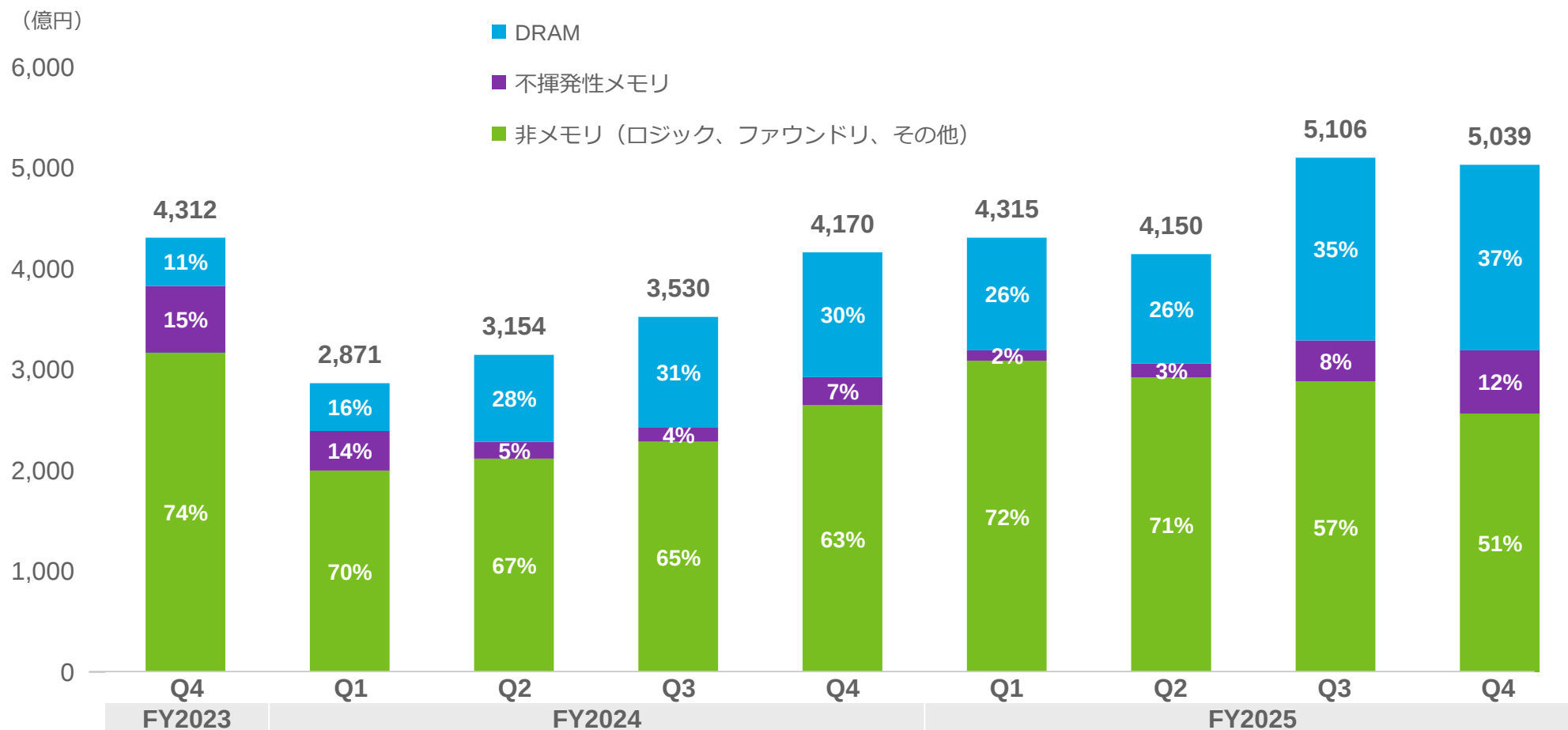
損益状況（四半期）

(億円)



	FY2024	FY2025			
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
■ 売上高	5,472	5,550	5,665	6,545	6,554
■ 営業利益	1,452	1,657	1,481	1,996	1,837
■ 親会社株主に帰属する当期純利益	1,249	1,261	1,177	1,572	1,429
○ 売上総利益率	46.8%	47.6%	45.9%	47.6%	47.4%
○ 営業利益率	26.5%	29.9%	26.2%	30.5%	28.0%

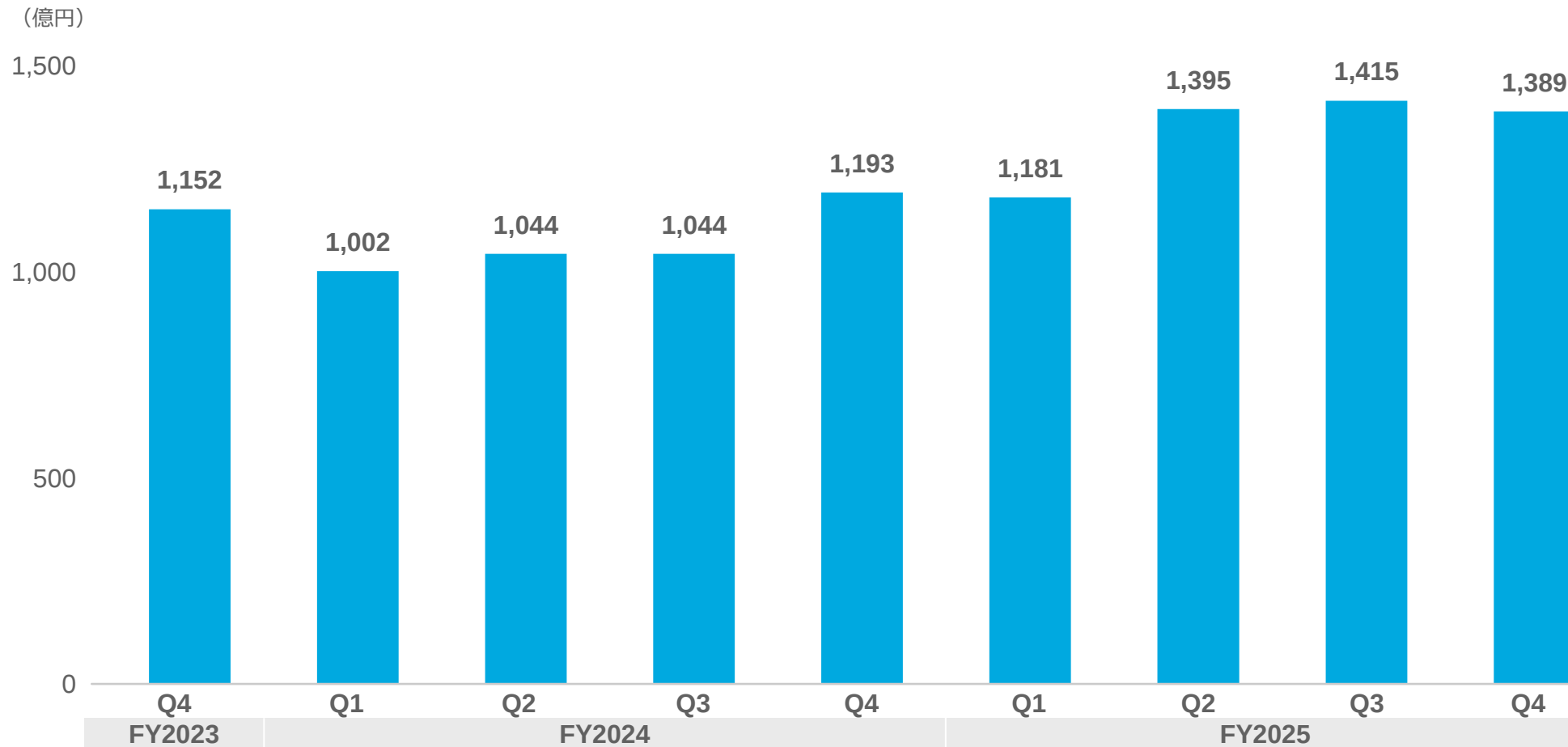
SPE新規装置 アプリケーション別売上構成比（四半期）



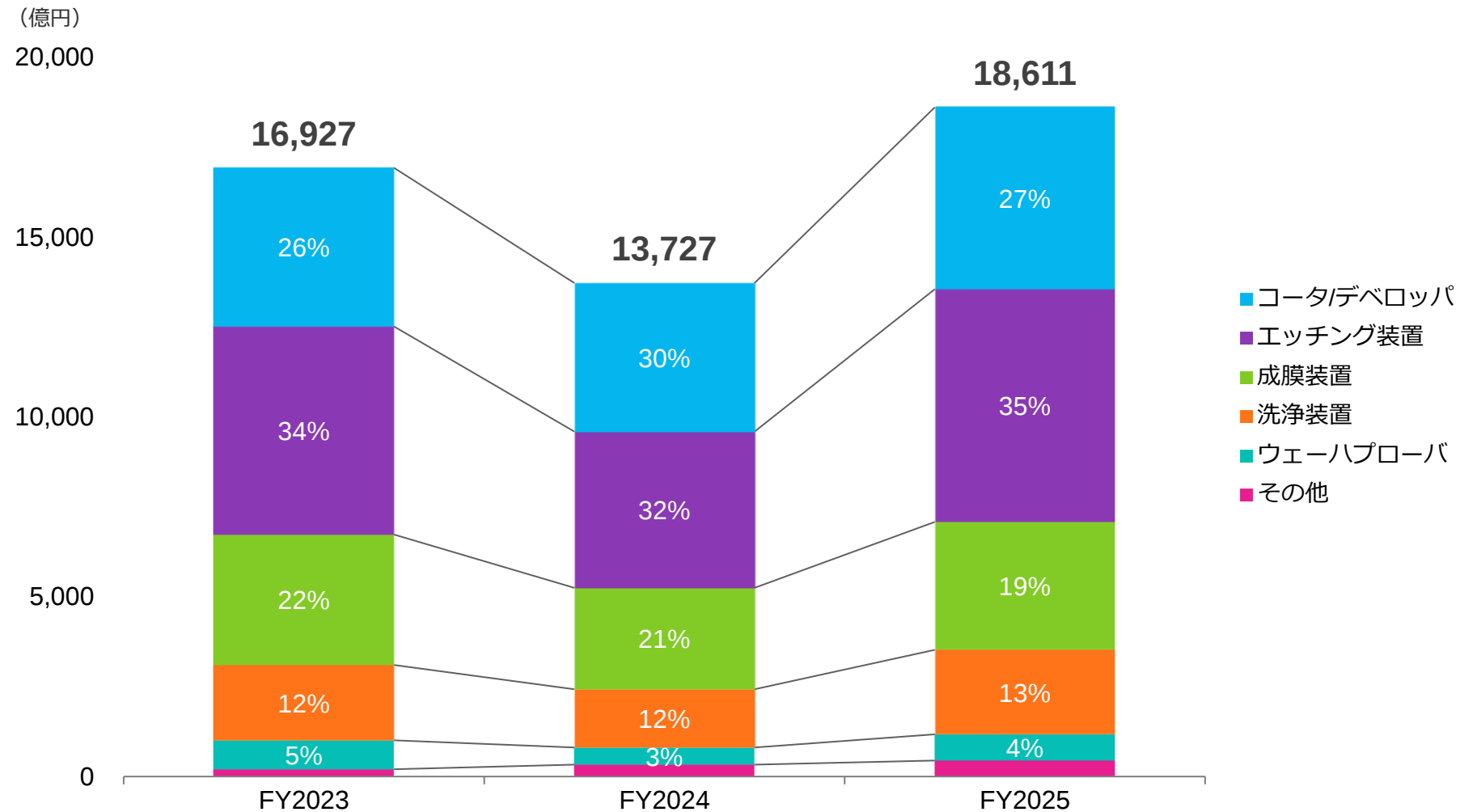
1. SPE（Semiconductor Production Equipment）：半導体製造装置

2. グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューションの売上高は含まれていません。

フィールドソリューション売上高（四半期）

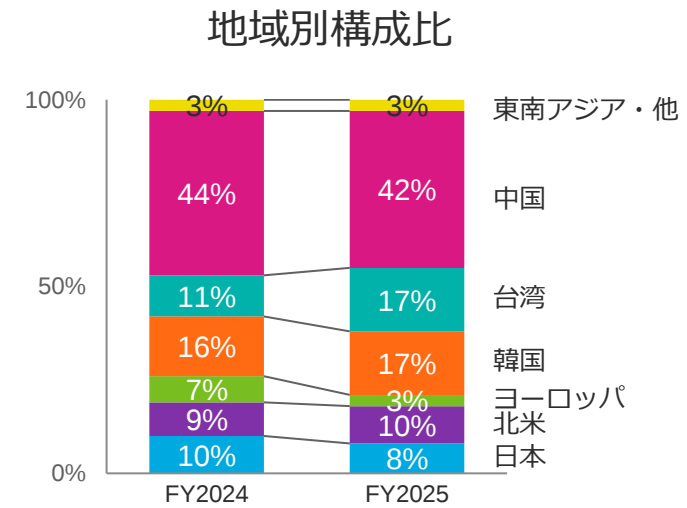
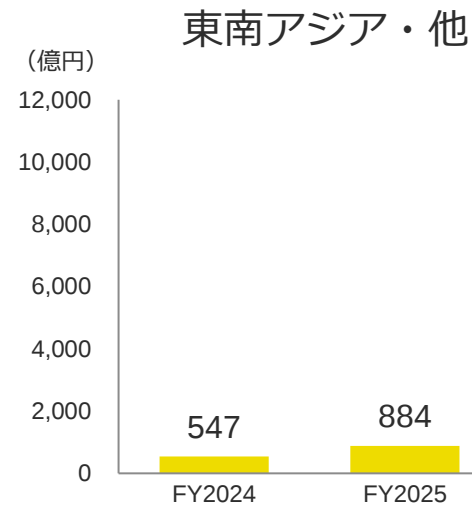
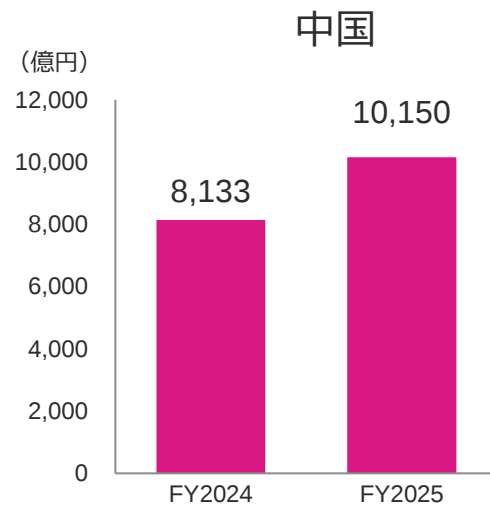
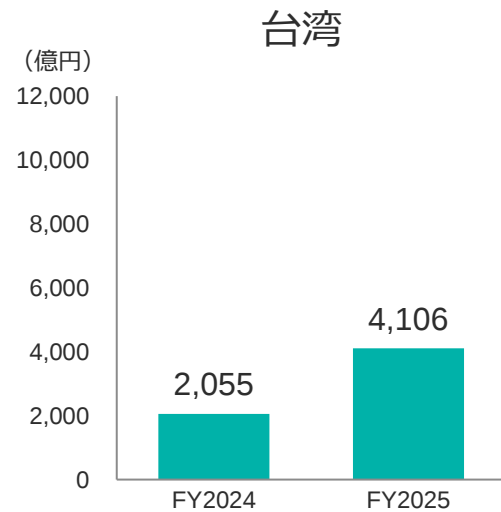
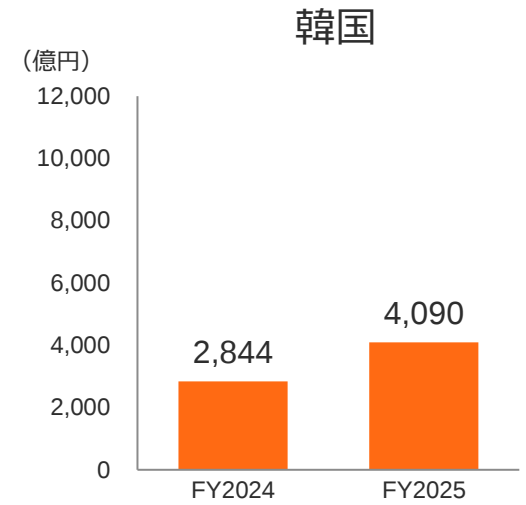
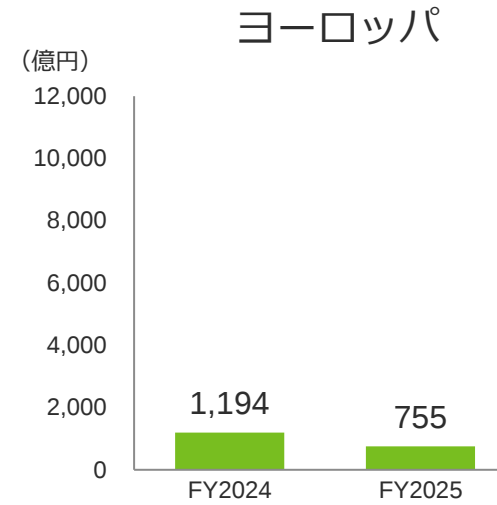
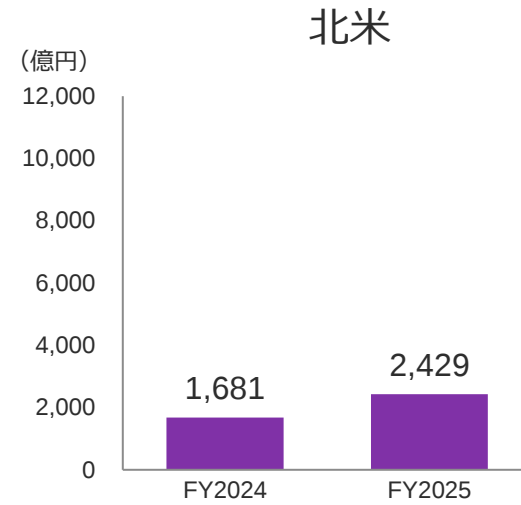
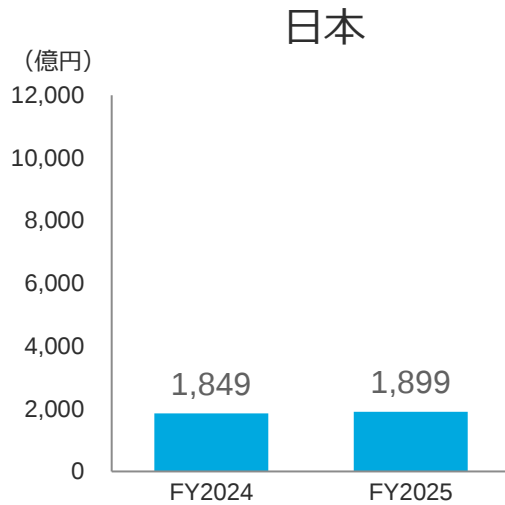


SPE新規装置 製品別売上構成比

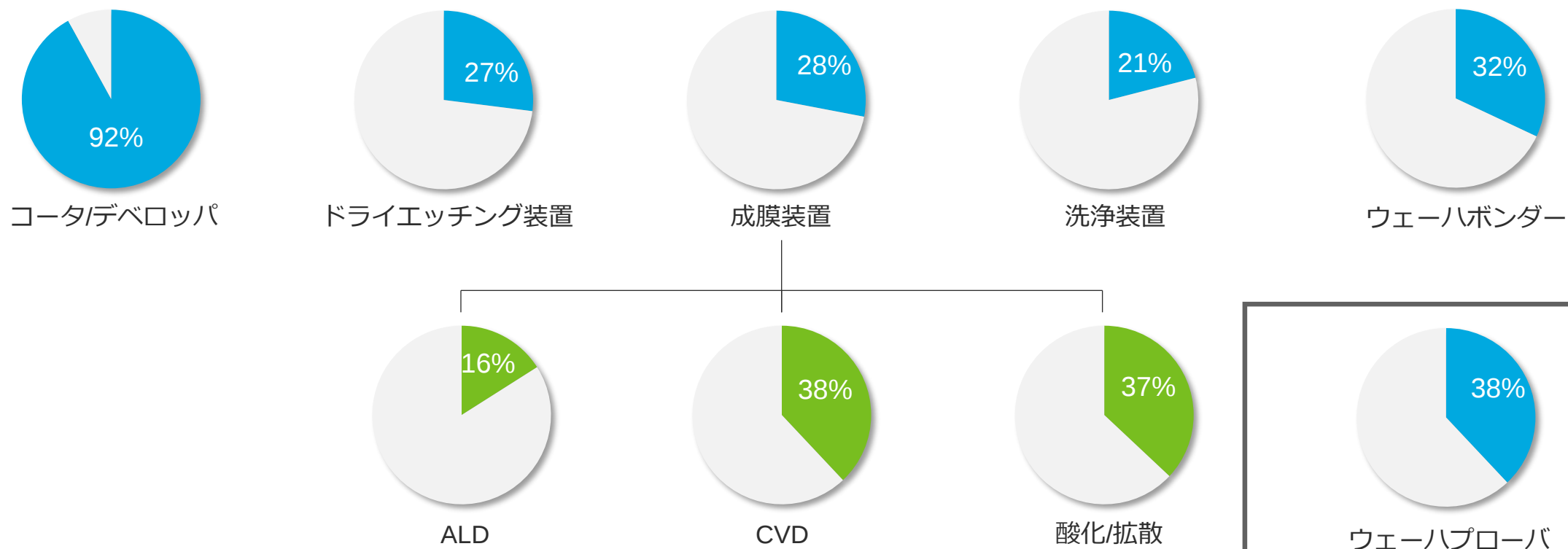


グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューションの売上高は含まれておりません

地域別売上高



主要プロダクト 世界市場シェア（CY2024）



出所

Gartner®, Market Share: Semiconductor Wafer Fab Equipment, Worldwide, 2024, Bob Johnson and Menglin Cao, 21 April 2025, Revenue from Shipments basis.

チャートはガートナーリサーチに基づき、東京エレクトロンが作成。ここに記載のある数値は、東京エレクトロンにより算出されたものです。

コータ/デベロッパ: Photoresist Processing (Track), ドライエッチング装置: Dry Etch, 成膜装置: Tube CVD + Atomic Layer Deposition Tools + Oxidation/ Diffusion Furnaces + Nontube LPCVD, ALD: Atomic Layer Deposition Tools, CVD: Tube CVD + Nontube LPCVD, 酸化/拡散: Oxidation/Diffusion Furnaces, 洗浄装置: Single Wafer Processors + Wet Stations + Batch Spray Processors + Scrubbers + Other Clean Equipment ウェーハボンダー: Wafer Bonder GARTNERは、Gartner Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved. Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。本書に記載するGartnerのコンテンツ（以下「Gartnerコンテンツ」）は、Gartnerシンジケート・サブスクリプション・サービスの一部としてGartner, Inc.（以下「Gartner」）が発行したリサーチ・オピニオンまたは見解を表すものであり、事実を述べているものではありません。Gartnerコンテンツの内容はいずれも、そのコンテンツが発行された当時の内容であり、本書が発行された日の内容ではありません。また、Gartnerコンテンツに記載されている見解は予告なく変更されることがあります。

出所

半導体製造装置（ウェーハプローバ）: Auto Probers,:

TechInsights Inc., April 2025

図はTechInsights Inc.に基づき、東京エレクトロンが作成。



TOKYO ELECTRON